



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20110620000
2011 年 6 月 30 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 

HVAL-SLL SOICパッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、30 日以内にご連絡が無い場合には、本変更をご承認いただけただけのものとして判断させていただきます。変更品評価用サンプルもしくは追加データご入用の場合には、本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	<input type="checkbox"/> Initial notice (Plan)	<input checked="" type="checkbox"/> Final notice		
変更概要	Design/Specification	<input type="checkbox"/> Design	<input type="checkbox"/> Electrical	<input type="checkbox"/> Mechanical
	Wafer Fab	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	Wafer Bump	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input type="checkbox"/> Material
	<input checked="" type="checkbox"/> Assembly	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	<input checked="" type="checkbox"/> Material
	Test	<input type="checkbox"/> Site	<input type="checkbox"/> Process	
	Others	<input type="checkbox"/> Packing/Shipping/Labeling <input type="checkbox"/> -		
変更内容	HVAL-SLL SOIC パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイヤ変更 現行 : Au(金)線 変更後 : Cu(銅)線			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	10月上旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	<input type="checkbox"/> 計画	<input checked="" type="checkbox"/> 終了		
製品表示	<input checked="" type="checkbox"/> 変更無し	<input type="checkbox"/> 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：弊社 HVAL-SLL (汎用リニアロジック) SOIC パッケージ 一部製品について、現行 Au(金)線ボンディングワイヤを使用して製造していますが、機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為に、Cu(銅)線ボンディングワイヤに変更します。ワイヤ径の変更については下記を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外觀, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイヤ	Au(金)線	Cu(銅)線

現行 Au(金)線 ワイヤ径	変更後 Cu(銅)線 ワイヤ径
0.8 Mils, 1.15 Mils	1.0 Mils

理由：機械/電気的特性の向上, 同種製品の組立技術推移対応及び供給能力/部材調達利便性向上の為

詳細：

次の4製品のサンプルは、現時点(本通知発行時)で入手可能です。

SN74LV14DR, CD4053BM96, LM358DR, RC4558DR.

対象製品リスト

対象製品名				
CD4051BM96	LM2903DRG4	MAX3232CDR	SN74HC148DRE4	SN74HCT32DRG4
CD4051BM96E4	LM2904DR	MAX3232CDRE4	SN74HC148DRG4	SN74HCU04DR
CD4051BM96G4	LM2904DRE4	MAX3232CDRG4	SN74HC14DR	SN74HCU04DRE4
CD4052BM96	LM2904DRG4	MAX3232IDR	SN74HC14DRE4	SN74HCU04DRG4
CD4052BM96E4	LM293ADR	MAX3232IDRE4	SN74HC14DRG4	SN74LV14ADR
CD4052BM96G4	LM293ADRG4	MAX3232IDRG4	SN74HC164DR	SN74LV14ADRG4
CD4053BM96	LM293DR	NE555DR	SN74HC164DRG4	SN74LVC07ADR
CD4053BM96E4	LM293DRG4	NE555DRE4	SN74HC165DR	SN74LVC07ADRE4
CD4053BM96G4	LM311DR	NE555DRG4	SN74HC165DRE4	SN74LVC07ADRG4
CD74HC4051M96	LM311DRE4	RC4558DR	SN74HC165DRG4	SN74LVC14ADR
CD74HC4051M96E4	LM311DRG4	RC4558DRG4	SN74HC166DR	SN74LVC14ADRE4
CD74HC4051M96G4	LM324ADR	SA555DR	SN74HC166DRG4	SN74LVC14ADRG4
CD74HC4052M96	LM324ADRE4	SA555DRG4	SN74HC174DR	TL064IDR

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

CD74HC4052M96G4	LM324DRG4	SN74AHC14DR	SN74HC174DRE4	TL0641DRG4
CD74HC4053M96	LM324DR	SN74AHC14DRE4	SN74HC174DRG4	TL074CDR
CD74HC4053M96E4	LM324DRE4	SN74AHC14DRG4	SN74HC259DR	TL074CDRE4
CD74HC4053M96G4	LM324DRG4	SN74AHC125DR	SN74HC259DRE4	TL074CDRG4
CD74HC4094M96	LM339ADR	SN74HC00DR	SN74HC259DRG4	TL084CDR
CD74HCT165M96	LM339ADRE4	SN74HC00DRE4	SN74HC32DR	TL084CDRE4
CD74HCT165M96G4	LM339ADRG4	SN74HC00DRG4	SN74HC32DRE4	TL084CDRG4
HPA00999ADR	LM339DR	SN74HC02DR	SN74HC32DRG4	TL494CDR
LM224ADR	LM339DRE4	SN74HC02DRE4	SN74HC595DR	TL494CDRE4
LM224ADRE4	LM339DRG4	SN74HC02DRG4	SN74HC595DRE4	TL494CDRG4
LM224DR	LM358ADR	SN74HC04DR	SN74HC595DRG4	TL4941DR
LM224DRG4	LM358ADRE4	SN74HC04DRE4	SN74HC74DR	TL4941DRG4
LM239DR	LM358ADRG4	SN74HC04DRG4	SN74HC74DRE4	TL594CDR
LM239DRG4	LM358DR	SN74HC05DR	SN74HC74DRG4	TL594CDRE4
LM258ADR	LM358DRE4	SN74HC05DRE4	SN74HCT04DR	TL594CDRG4
LM258DR	LM358DRG4	SN74HC05DRG4	SN74HCT04DRE4	ULN2003ADR
LM258DRG4	LM393ADR	SN74HC08DR	SN74HCT04DRG4	ULN2003ADRE4
LM2901DR	LM393ADRE4	SN74HC08DRE4	SN74HCT138DR	ULN2003ADRG4
LM2901DRE4	LM393ADRG4	SN74HC08DRG4	SN74HCT138DRE4	ULN2003A1DR
LM2901DRG4	LM393DR	SN74HC125DR	SN74HCT138DRG4	ULN2003A1DRE4
LM2902DR	LM393DRE4	SN74HC125DRE4	SN74HCT14DR	ULN2004ADR
LM2902DRE4	LM393DRG4	SN74HC125DRG4	SN74HCT14DRE4	ULN2004ADRE4
LM2902DRG4	MAX232DR	SN74HC138DR	SN74HCT14DRG4	ULN2004ADRG4
LM2903DR	MAX232DRE4	SN74HC138DRE4	SN74HCT32DR	
LM2903DRE4	MAX232DRG4	SN74HC148DR	SN74HCT32DRE4	

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010年6月17日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	CD4053BM96	-	-	
Assembly Site:	ASESH	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	EY1000063	Mold Compound:	EN2000506	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu	Lead frame (Finish, Base):	Matte Tin, Cu	
MSL:	JEDEC L-1/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Life Test	150C, 300 Hrs		77/0	
Electrical Characterization	-		Approved	
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs		77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Manufacturability	per mfg. Site specification		Approved	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2010年6月17日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	LM358DR		-	-
Assembly Site:	ASESH		Package/Code/Pins:	SOIC/D/8
Mount Compound:	EY1000063		Mold Compound:	EN2000506
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu		Lead frame (Finish, Base):	Matte Tin, Cu
MSL:	JEDEC L-1/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Life Test	150C, 300 Hrs		77/0	
Electrical Characterization	-		Approved	
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs		77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Manufacturability	per mfg. Site specification		Approved	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2010年6月17日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	RC4558DR		-	-
Assembly Site:	ASESH		Package/Code/Pins:	SOIC/D/8
Mount Compound:	EY1000063		Mold Compound:	EN2000506
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu		Lead frame (Finish, Base):	Matte Tin, Cu
MSL:	JEDEC L-1/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Life Test	150C, 300 Hrs		116/0	
Electrical Characterization	-		Approved	
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs		77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Manufacturability	per mfg. Site specification		Approved	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2010年6月17日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	SN74LV14ADR		-	-
Assembly Site:	ASESH		Package/Code/Pins:	SOIC/D/14
Mount Compound:	EY1000063		Mold Compound:	EN2000506
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Cu		Lead frame (Finish, Base):	Matte Tin, Cu
MSL:	JEDEC L-1/260C		-	-
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
**Life Test	150C, 300 Hrs		77/0	
Electrical Characterization	-		Approved	
**High Temp. Storage Bake	150C, 1000 Hrs		77/0	
**Biased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**Unbiased HAST	130C/85%RH, 96 Hrs		77/0	
**T/C	-65C/150C, 500 Cyc		77/0	
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units		76/0	
Manufacturability	per mfg. Site specification		Approved	
Notes: ** Preconditioning sequence: JEDEC L-1/260C				